

中信证券股份有限公司

关于厦门优迅芯片股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“优迅股份”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对优迅股份本次拟使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）2,000万股，发行价格51.66元/股，募集资金总额为人民币103,320.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币92,768.83万元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月12日出具的《厦门优迅芯片股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0063号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资项目基本情况

《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目	46,780.65	46,780.65

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
2	车载电芯片研发及产业化项目	16,908.47	16,908.47
3	800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目	17,217.38	17,217.38
合计		80,906.50	80,906.50

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超募资金为 11,862.34 万元。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况

根据《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“车载电芯片研发及产业化项目”和“800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目”的实施主体为全资子公司武汉芯智光联科技有限公司（以下简称“芯智光联”），公司拟分别借款 16,908.47 万元和 17,217.38 万元用于上述项目实施。借款期限自实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况，可续借或提前偿还。

本公司提供的借款将存放于芯智光联开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“车载电芯片研发及产业化项目”和“800G 及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目”的实施，不得用作其他用途。

四、本次提供借款对象的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	武汉芯智光联科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MADFNAB660
法定代表人	柯腾隆
注册资本	1,000 万元
成立日期	2024 年 3 月 29 日
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路一号华中曙光软件园内恒隆大厦 A 栋 A301 室（自贸区武汉片区）
经营范围	集成电路设计，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，电子产品销售，电子元器件零售，软件开发，软件销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，技术进出口，货物进出口。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二) 最近一年一期的主要财务数据

单位：万元

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 1-6 月/2025.06.30	822.37	133.19	0.44	-455.49
2024 年度/2024.12.31	753.35	540.48	-	-514.73

注：芯智光联 2024 年度、2025 年 1-6 月财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

五、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司芯智光联提供借款，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

同时，芯智光联是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。

六、本次使用募集资金向全资子公司提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司和芯智光联已与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

七、本次使用募集资金向全资子公司提供借款履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

本次提供借款不涉及改变募集资金投向及实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次提供借款属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东大会审议。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关要求。

综上，保荐人对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

戴五七

戴五七

马锐

马 锐

